



团 体 标 准

T/CWAN 0021—2021

金锡合金预成形焊片及应用推荐规范

Au-Sn solder preforms and recommended application profile

2021-08-10 发布

2021-10-01 实施

中国焊接协会 发 布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 金锡合金预成形焊片的技术要求 1

5 金锡合金预成形焊片的检验规则 3

6 金锡合金预成形焊片的应用推荐规范 4

附录 A（规范性） 金锡合金预成形焊片的润湿性检测方法 5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国焊接协会提出并归口。

本文件起草单位：广州先艺电子科技有限公司、南昌航空大学、合肥圣达电子科技实业有限公司、重庆科技学院、哈尔滨焊接研究院有限公司、中国电子科技集团第二十九研究所、郑州机械研究所有限公司、华北水利水电大学、黑龙江科技大学。

本文件主要起草人：王善林、陈卫民、吴懿平、陈玉华、尹立孟、张凤伟、孙晓梅、罗建强、司浩、王永东、马一鸣、王捷、王星星、谢吉林、秦建、方乃文。

金锡合金预成形焊片及应用推荐规范

1 范围

本文件规定了金锡合金预成形焊片的技术要求、检验规则和应用推荐规范。

本文件适用于微电子器件电路封装、半导体分立器件封装及集成电路金属外壳封装用金锡合金预成形焊片。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1425 贵金属及其合金熔化温度范围的测量 热分析试验方法

GB/T 2828 计数抽样检验程序

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判断

GB/T 8979 纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T 17684 贵金属及其合金术语

GB/T 33148 钎焊术语

GJB 6468 金锡合金钎料规范

YS/T 746 无铅锡基焊料化学分析方法

3 术语和定义

GB/T 33148 及 GB/T 17684 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

预成形焊片 solder preforms

通过冲裁、切割等加工手段对钎料带材进行加工，从而制成与待钎焊面形状相适应的钎料，在钎焊前装配在钎焊缝隙中。常见的形状包括片状、环状等。

4 金锡合金预成形焊片的技术要求

4.1 化学成分

金锡合金预成形焊片的化学成分应符合表 1 的规定，数值修约按照 GB/T 8170 的规定进行。